## 11.5.3 MRAM

MRAM 是非揮發性的磁性隨機存取記憶體,其儲存資訊的方式與硬碟 (Hard Disk)類似是利用具高敏感度的磁電阻材料製成,其擁有 DRAM 隨機存取的特質,記憶容量有潛力可與 DRAM 抗衡;資料寫入與讀取速度接近 SRAM;同時又具備低耗能、非揮發的特性,寫入次數又可達到無限次數,更重要的是其耗電量亦不會太大,並可以現有的CMOS製程生產,因此被公認為新一代的記憶體。總和來說,MRAM 含有快閃記憶體、DRAM、SRAM 與EEPROM的綜合能力。

MRAM 主要是以自旋電子(Spintronics)方式,透過磁化方向的不同來記錄 0 與 1,只要不增加外部磁場,磁化的方向就不會改變。其構造是在 2 個強磁性層中夾有一非強磁性層,2 層強磁性層的磁化朝相同方向(平行)時,是為 0,相反狀態(反平行)時則為 1,電阻將隨磁化方向平行或反平行呈現不同大小,如圖 11-26。

不過 MRAM 目前仍存在待解決的課題,方能將效能發揮極至,這些課題包括如何使磁電阻材料相容於標準CMOS製程技術以提高容量、及開發低溫製程等。

## 11.5.4 OUM

OUM 是利用 Ge、Sb 與 Te(Ge<sub>2</sub>Sb<sub>2</sub>Te<sub>5</sub>, GST)等硫系三化合物為材質之薄膜來儲存資料。由於其是透過電晶體控制電源使其產生相變方式來儲存資料,因此,其在讀寫速度與次數上,都明顯落後 MRAM 與 FeRAM。但是 OUM 在記憶體細胞僅有 MRAM 與 FRAM 的 1/3,寫入電壓低,以及其易於 Logic 電路整合的優勢,使得 OUM 有相當發展的潛能。